



LOTPASTE SC BLF04

Typ RE L0

Die Lotpaste **SOLDER CHEMISTRY BLF 04** ist als neustes Produkt gezielt für alle sogenannten **bleifreien SMT-Anwendungen** entwickelt worden. Obwohl dank der Anwendung von modernen chemischen Mitteln wie Kunststoffen und –harzen, Aktivatorensystemen etc. alle unsere bisherigen Lotpasten von Anfang an sehr gut mit den bleifreien Legierungen kombinierbar waren, haben die letzten Erkenntnisse beim „Bleifreilöten“ zu dieser Neuentwicklung beigetragen. Eine sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von ISO-, EN-, IPC- und MIL-Normen lag auch ihr selbstverständlich zugrunde.

Die **BLF 04** ist physikalisch gesehen eine gleichmäßige Mischung aus einem **bleifreien Lotpulver**, in allen erforderlichen Legierungen und Körnungen lieferbar, mit einem organischen Bindemittel auf **Kunsthartzbasis**, das der Kl. RE L0 nach J-STD-005 oder RMA-Qualifizierung entspricht.

Außer der hervorragenden Konturenstabilität, keiner Lotkugel- oder Spritzerbildung, einer langzeitigen Verarbeitbarkeit und langen Standzeit, sowie hoher Temperaturstabilität, zeichnen diese Paste folgende Vorteile aus:

- * **BLF 04*** Exzellente Resistenz gegen Feuchtigkeit. Sehr lange Klebrigkeit!!!
- * **BLF 04*** Bildet sehr homogene, lunkerfreie Lötstellen!
- * **BLF 04*** Eine hervorragende Druckqualität, stundenlang! Stabile Viskosität.
- * **BLF 04*** Eine feststoffarme Paste mit nur 5,8% Rückstand bei 89% Metallgehalt.
- * **BLF 04*** Die Rückstände entsprechen der RE L0 Klassifizierung.
- * **BLF 04*** Hinterlässt keine teeartigen Rückstände in der Lötanlage.
- * **BLF 04*** Lötet problemlos auch auf leicht korrodierten Oberflächen.

PHYSIKALISCHE DATEN

<u>Bevorzugte Legierungen</u>	<u>Schmelzpunkt</u>	Gemäß Internationalem Standard liefern wir diese Legierungen in den Klassen:
Sn96,5/Ag3,5	221°C	
Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7	217 - 219°C	Kl.3 (T3) 25 - 45 µm
Sn96,5/Ag3/Cu0,5	217°C	Kl.4 (T4) 20 - 35 µm
Sn99,3/Cu0,7	227°C	Kl.5 (T5) 10 - 25 µm
Sn97/Cu3	227 - 300°C	

VISKOSITÄT (Pa.S) ± 10% gemessen nach Brookfield RVT–DV II Viskosimeter mit 89% Metallgehalt:

<u>Viskosität:</u> *		Konturenstabilität – DIN 32513		Solderballing nach IPC	Benetzung nach IPC
		Sofort	20min 80°C		
600 Pas	Pulverklasse III	Kl.1 = 0,2	0,2	1	1
650 Pas	Pulverklasse IV	Kl.2 = 0,2	0,3		

OBERFLÄCHENWIDERSTAND (SIR) und elektrolytische Korrosionswirkung nach DIN 32513

Messung am	4.Tag	<u>21.Tag</u>
	3,7 x 10 ¹¹	2,9 x 10 ¹¹

